

Title (en)

Method of manufacturing a tin plated strip

Title (de)

Verfahren zur Herstellung eines verzinnten Bandes

Title (fr)

Procédé pour la fabrication d'une bande étamée

Publication

**EP 0864666 A1 19980916 (DE)**

Application

**EP 98103664 A 19980303**

Priority

DE 19710292 A 19970313

Abstract (en)

The method for producing a compound strip (10) with a base strip (1) consisting of a metal or an alloy, and a coating consisting of tin or a tin alloy consists of the following steps; a) the base material is heated in a reducing atmosphere; b) it is then coated with a layer within a mu m range; c) the resulting compound material is rapidly cooled. When the base strip consists of copper or a copper alloy, the step a) involves heating to 80-300 degrees C for 3-30 s. The step b) is carried out by pulling the base strip through a bath (5) with a tin alloy.

Abstract (de)

Zur Verbesserung der Haftung einer Zinn- oder Zinnlegierungsschicht auf der Oberfläche eines bandförmigen Grundmaterials (1) aus Kupfer oder einer Kupferlegierung wird erfahrungsgemäß: a) das Grundmaterial (1) in einer reduzierenden Gasatmosphäre für 3 bis 30 s auf eine Temperatur T von 80 bis 300 °C erwärmt, b) das Grundmaterial (1) durch ein Zinn- oder Zinnlegierungsbad (5) gezogen und c) das entstandene Verbundmaterial (10) schnell abgekühlt. <IMAGE>

IPC 1-7

**C23C 2/02; C23C 2/08; C23C 2/40; C23C 2/28**

IPC 8 full level

**C23C 2/02** (2006.01); **C23C 2/08** (2006.01); **C23C 2/28** (2006.01); **C23C 2/40** (2006.01)

CPC (source: EP US)

**C23C 2/0038** (2022.08 - EP US); **C23C 2/0222** (2022.08 - EP US); **C23C 2/08** (2013.01 - EP)

Citation (search report)

- [XA] US 5077094 A 19911231 - MCCALL JAMES L [US], et al
- [A] US 4719962 A 19880119 - HAOUR GEORGES [CH], et al
- [A] US 5491036 A 19960213 - CAREY II JAY F [US], et al
- [A] DE 19501747 A1 19951221 - BERKMAN LOUIS CO [US]
- [A] EP 0667403 A1 19950816 - KABELMETAL AG [DE]

Cited by

CN104060210A; CN115449737A

Designated contracting state (EPC)

DE ES FI FR GB IT

DOCDB simple family (publication)

**EP 0864666 A1 19980916; EP 0864666 B1 20010627**; DE 19710292 A1 19980917; DE 19710292 C2 20010503; DE 59800909 D1 20010802; ES 2159901 T3 20011016

DOCDB simple family (application)

**EP 98103664 A 19980303**; DE 19710292 A 19970313; DE 59800909 T 19980303; ES 98103664 T 19980303